

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書の訂正報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条の2第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年12月4日

**【事業年度】** 第96期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

**【会社名】** サンケン電気株式会社

**【英訳名】** Sanken Electric Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 飯島貞利

**【本店の所在の場所】** 埼玉県新座市北野三丁目6番3号

**【電話番号】** (048)472 1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部財務IR統括部長 村野泰史

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県新座市北野三丁目6番3号

**【電話番号】** (048)472 1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部財務IR統括部長 村野泰史

**【縦覧に供する場所】** サンケン電気株式会社 大阪支店  
(大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号  
(明治安田生命大阪梅田ビル))  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年6月21日に提出いたしました第96期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 4 関係会社の状況

#### 第2 事業の状況

##### 2 生産、受注及び販売の状況

###### (1) 生産実績

###### (2) 受注状況

#### 第3 設備の状況

##### 2 主要な設備の状況

###### (2) 国内子会社

###### (3) 在外子会社

#### 第5 経理の状況

##### 1 連結財務諸表等

###### (1) 連結財務諸表

連結附属明細表

借入金等明細表

##### 2 財務諸表等

###### (1) 財務諸表

注記事項

(リース取引関係)

3 転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額

(2) リース債務

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### 第一部 【企業情報】

#### 第1 【企業の概況】

## 4 【関係会社の状況】

(訂正前)

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合	関係内容
				所有割合(%)	
(連結子会社)					
3 石川サンケン株式会社	石川県羽咋郡 志賀町	95,500	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
3 山形サンケン株式会社	山形県東根市	100,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
鹿島サンケン株式会社	茨城県神栖市	75,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
福島サンケン株式会社	福島県二本松市	50,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 3名
サンケンオプトプロダク ツ株式会社	石川県羽咋郡 志賀町	90,000	半導体デバイス C C F L P S	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
大連三壘電気有限公司	中国遼寧省 大連市	千円 66,349	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 1名
大連三壘貿易有限公司	中国遼寧省 大連市	千円 512	P M	100.0(100.0)	当社製品の販売を行っております。 当社の資材調達支援活動を行っております。
3, 7 サンケン ノースアメリ カ インク	米 国 マ サ チューセッツ 州 ウースター	千米ドル 10,250	半導体デバイス	100.0( )	半導体デバイス製品の開発、製造及び販売を行っております。 役員兼任 2名
3, 6, 10 アレグロ マイクロ システムズ エルエル シー	米 国 マ サ チューセッツ 州 ウースター	千米ドル 250	半導体デバイス	100.0(100.0)	半導体デバイス製品の開発、製造及び販売を行っております。
10 ポーター セミコンダク ター エルエルシー	米 国 ミネソタ州 ブルーミント ン	千米ドル 10,000	半導体デバイス	100.0(100.0)	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金を貸し付けております。
8 アレグロ マイクロ システムズ フィリピン インク	フィリピン マニラ	千フィリピン ペソ 800,000	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の製造を行っております。
4 アレグロ マイクロ システムズ フィリピン リアルティー インク	フィリピン ムンティンル バ	千フィリピン ペソ 31,000	半導体デバイス	40.0(40.0)	
9 アレグロ マイクロ システムズ(タイランド) カンパニー リミテッド	タイ バンコク	千タイバーツ 365,000	半導体デバイス	100.0(100.0)	
アレグロ マイクロ システムズ ヨーロッパ リミテッド	英国サリー	千ポンド 1	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の販売を行っております。
アレグロ マイクロ システムズ アルゼンチ ン エスエー	アルゼンチン ブエノスアイ レス	千アルゼンチ ンペソ 12	半導体デバイス	100.0(100.0)	
アレグロ マイクロシ ステムズ ビジネス デイ ペロップメント インク	米 国 マ サ チューセッツ 州 ウースター	千米ドル 250	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の販売及び技術支援活動を行っております。
埃戈羅(上海)微電子商貿 有限公司	中国上海市	千円 1,449	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の販売を行っております。
サンケン パワー システムズ(ユークー) リミテッド	英 国 ブ リ ッ ジェンド	千ポンド 5,992	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の販売及び技術支援活動を行っております。 役員兼任 1名
3 ピーティー サンケン インドネシア	インドネシア 西ジャワ州 ブカシ	千米ドル 21,000	P M	100.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 2名
韓国サンケン株式会社	韓国昌原市	千ウォン 759,000	半導体デバイス C C F L	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 1名

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合	関係内容
				所有割合(%)	
三壘力達電気(江陰) 有限公司	中国江蘇省 江陰市	千元 28,973	P S	60.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与 を行っております。
サンケン エレクトリック コリア株式会社	韓国 ソウル特別市	千ウォン 1,200,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動及び技術支援活動を行っております。 役員兼任 3名
三壘電気(上海)有限公司	中国上海市	千元 4,138	半導体デバイス C C F L P M	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動、技術支援活動及び品質対応支援活動 を行っております。 役員兼任 2名
サンケン エレクトリック ホンコンカンパ ニー リミテッド	中国香港	千香港ドル 1,000	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動を行っております。 役員兼任 1名
台湾三壘電気股份 有限公司	台湾台北市	千台湾ドル 8,000	半導体デバイス C C F L P M	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動及び技術支援活動を行っております。 役員兼任 2名
サンケン エレクトリック シンガポール プライ ベート リミテッド	シンガポール	千米ドル 170	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の販売を行っております。 役員兼任 1名
サンケン エレクトリック (マレーシア)エスディーエ ヌ ビーエイチディー	マレーシア クアラ Lumpur エル	千マレーシア リンギット 2,000	P M	100.0( )	当社製品の販売を行っております。
サンケン電設株式会社	埼玉県川越市	10,000	P S	100.0( )	当社製品の販売、搬入及び据付工事を行って おります。 当社は運転資金を貸し付けております。 役員兼任 1名
サンケンビジネスサービス 株式会社	埼玉県新座市	90,000	全社	100.0( )	当社グループの事務代行サービスを行って おります。
サンケンロジスティクス 株式会社	埼玉県新座市	80,000	半導体デバイス C C F L P M P S	100.0( )	当社半導体デバイス、C C F L、P M及びP Sの物流事業を行っております。 役員兼任 2名

(注) 1 連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2 議決権の所有割合欄の( )は間接所有であります。

3 特定子会社であります。

4 支配力基準により連結子会社に含まれております。

5 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

6 アレグロ マイクロシステムズ エルエルシーについては売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連  
結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 40,626百万円

(2) 経常利益 5,281百万円

(3) 当期純利益 3,790百万円

(4) 純資産額 28,047百万円

(5) 総資産額 36,307百万円

7 当連結会計年度において、サンケン ノースアメリカ インクを新たに設立したことにより、提出会社の連  
結子会社となりました。

8 当連結会計年度において、アレグロ マイクロシステムズ フィリピン インクの資本金が400,000千フィ  
リピンペソから800,000千フィリピンペソに増加しています。

9 当連結会計年度において、アレグロ マイクロシステムズ(タイランド)カンパニー リミテッドの資本金  
が2,000千タイバツから365,000千タイバツに増加しています。

10 当連結会計年度において、アレグロ マイクロシステムズ インク及びポラー セミコンダクター イン  
クは、それぞれアレグロ マイクロシステムズ エルエルシー及びポラー セミコンダクター エルエル  
シーと商号変更いたしました。

(訂正後)

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合	関係内容
				所有割合(%)	
(連結子会社)					
3 石川サンケン株式会社	石川県羽咋郡 志賀町	95,500	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
3 山形サンケン株式会社	山形県東根市	100,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
鹿島サンケン株式会社	茨城県神栖市	75,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
福島サンケン株式会社	福島県二本松市	50,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 3名
サンケンオプトプロダク ツ株式会社	石川県羽咋郡 志賀町	90,000	半導体デバイス C C F L P S	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 4名
大連三壘電気有限公司	中国遼寧省 大連市	千元 66,349	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与を行っております。 役員兼任 1名
大連三壘貿易有限公司	中国遼寧省 大連市	千元 512	P M	100.0(100.0)	当社製品の販売を行っております。 当社の資材調達支援活動を行っております。
3, 7 サンケン ノースアメリ カ インク	米 国 マ サ チューセツ 州 ウースター	千米ドル 10,250	半導体デバイス	100.0( )	半導体デバイス製品の開発、製造及び販売を行っております。 役員兼任 2名
3, 6, 9 アレグロ マイクロ システムズ エルエル シー	米 国 マ サ チューセツ 州 ウースター	千米ドル 250	半導体デバイス	100.0(100.0)	半導体デバイス製品の開発、製造及び販売を行っております。
9 ポーラー セミコンダク ター エルエルシー	米国 ミネソタ州 ブルーミント ン	千米ドル 10,000	半導体デバイス	100.0(100.0)	当社製品の製造を行っております。 当社は設備資金及び運転資金を貸し付けており ます。
アレグロ マイクロ システムズ フィリピン インク	フィリピン マニラ	千フィリピン ペソ 400,000	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の製造を行っております。
4 アレグロ マイクロ システムズ フィリピン リアルティー インク	フィリピン ムンティンル バ	千フィリピン ペソ 31,000	半導体デバイス	40.0(40.0)	
8 アレグロ マイクロ システムズ(タイランド) カンパニー リミテッド	タイ バンコク	千タイバーツ 365,326	半導体デバイス	100.0(100.0)	
アレグロ マイクロ システムズ ヨーロッパ リミテッド	英国サリー	千ポンド 1	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の販売を行っております。
アレグロ マイクロ システムズ アルゼンチ ン エスエー	アルゼンチン ブエノスアイ レス	千アルゼンチ ンペソ 12	半導体デバイス	100.0(100.0)	
アレグロ マイクロシ ステムズ ビジネス デイ ベロップメント インク	米 国 マ サ チューセツ 州 ウースター	千米ドル 250	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の販売及び技術支援活動を行って おります。
埃戈羅(上海)微电子商 貿有限公司	中国上海市	千元 1,449	半導体デバイス	100.0(100.0)	関係会社製品の販売を行っております。
サンケン パワー システムズ(ユークー) リミテッド	英 国 フ リ ッ ジェンド	千ポンド 5,992	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の販売及び技術支援活動を行って おります。 役員兼任 1名
3 ピーティー サンケン インドネシア	インドネシア 西ジャワ州 ブカシ	千米ドル 21,000	P M	100.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与 を行っております。 役員兼任 2名
韓国サンケン株式会社	韓国昌原市	千ウォン 759,000	半導体デバイス C C F L	100.0( )	当社製品の製造を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与 を行っております。 役員兼任 1名

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合	関係内容
				所有割合(%)	
三壘力達電気(江陰) 有限公司	中国江蘇省 江陰市	千元 28,973	P S	60.0( )	当社製品の製造及び販売を行っております。 当社は運転資金の貸付並びに生産設備の貸与 を行っております。
サンケン エレクトリック 코리아株式会社	韓国 ソウル特別市	千ウォン 1,200,000	半導体デバイス	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動及び技術支援活動を行っております。 役員兼任 3名
三壘電気(上海)有限公司	中国上海市	千元 4,138	半導体デバイス C C F L P M	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動、技術支援活動及び品質対応支援活動 を行っております。 役員兼任 2名
サンケン エレクトリック ホンコンカンパ ニー リミテッド	中国香港	千香港ドル 1,000	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動を行っております。 役員兼任 1名
台湾三壘電気股份 有限公司	台湾台北市	千台湾ドル 8,000	半導体デバイス C C F L P M	100.0( )	当社製品の販売並びに当社製品の販売支援活 動及び技術支援活動を行っております。 役員兼任 2名
サンケン エレクトリック シンガポール プライ ベート リミテッド	シンガポール	千米ドル 170	半導体デバイス P M	100.0( )	当社製品の販売を行っております。 役員兼任 1名
サンケン エレクトリック (マレーシア)エスディーエ ヌ ビーエイチディー	マレーシア クアラランプー ル	千マレーシア リンギット 2,000	P M	100.0( )	当社製品の販売を行っております。
サンケン電設株式会社	埼玉県川越市	10,000	P S	100.0( )	当社製品の販売、搬入及び据付工事を行って おります。 当社は運転資金を貸し付けております。 役員兼任 1名
サンケンビジネスサービス 株式会社	埼玉県新座市	90,000	全社	100.0( )	当社グループの事務代行サービスを行って おります。
サンケンロジスティクス 株式会社	埼玉県新座市	80,000	半導体デバイス C C F L P M P S	100.0( )	当社半導体デバイス、C C F L、P M及びP Sの物流事業を行っております。 役員兼任 2名

(注) 1 連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2 議決権の所有割合欄の( )は間接所有であります。

3 特定子会社であります。

4 支配力基準により連結子会社に含まれております。

5 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

6 アレグロ マイクロシステムズ エルエルシーについては売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連  
結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 40,626百万円

(2) 経常利益 5,281百万円

(3) 当期純利益 3,790百万円

(4) 純資産額 28,047百万円

(5) 総資産額 36,307百万円

7 当連結会計年度において、サンケン ノースアメリカ インクを新たに設立したことにより、提出会社の連  
結子会社となりました。

8 当連結会計年度において、アレグロ マイクロシステムズ(タイランド)カンパニー リミテッドの資本金  
が2,000千タイバーツから365,326千タイバーツに増加しています。

9 当連結会計年度において、アレグロ マイクロシステムズ インク及びポラー セミコンダクター イン  
クは、それぞれアレグロ マイクロシステムズ エルエルシー及びポラー セミコンダクター エルエル  
シーと商号変更いたしました。

第2 【事業の状況】

2 【生産、受注及び販売の状況】

(訂正前)

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称	金額(百万円)	前年同期比(%)
半導体デバイス事業	99,357	97.4
C C F L 事業	1,034	55.8
P M 事業	14,146	79.6
P S 事業	15,571	94.3
合計	130,109	94.2

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
 2 金額は、販売価格で表示しております。  
 3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称	受注高		受注残高	
	金額(百万円)	前年同期比(%)	金額(百万円)	前年同期比(%)
半導体デバイス事業	92,315	103.2	13,936	87.6
C C F L 事業	886	48.2	29	124.9
P M 事業	13,725	76.7	1,498	76.0
P S 事業	15,708	95.9	2,801	107.7
合計	122,636	97.7	18,266	89.0

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

## (1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称	金額(百万円)	前年同期比(%)
半導体デバイス事業	<u>99,312</u>	97.4
C C F L 事業	<u>804</u>	<u>43.4</u>
P M 事業	14,146	79.6
P S 事業	15,571	94.3
合計	<u>129,835</u>	<u>94.0</u>

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 金額は、販売価格で表示しております。

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称	受注高		受注残高	
	金額(百万円)	前年同期比(%)	金額(百万円)	前年同期比(%)
半導体デバイス事業	92,315	103.2	13,936	87.6
C C F L 事業	886	48.2	29	<u>125.1</u>
P M 事業	13,725	76.7	1,498	76.0
P S 事業	15,708	95.9	2,801	<u>107.3</u>
合計	122,636	97.7	18,266	89.0

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



第3 【設備の状況】

2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(2) 国内子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
石川サンケン株式会社	堀松工場 他3工場 (石川県志賀町)	半導体 デバイス	製造設備	3,391	1,982	1,299 (463) 〔10〕	1,927	506	9,106	1,253
山形サンケン株式会社	(山形県東根市)	半導体 デバイス	製造設備	2,652	1,786	638 (65)	1,341	108	6,527	481
鹿島サンケン株式会社	(茨城県神栖市)	半導体 デバイス	製造設備	468	328	127 (8) 〔10〕	17	10	1,041	332
福島サンケン株式会社	(福島県二本松市)	半導体 デバイス	製造設備	1,333	764	300 (50)	495	65	2,958	334
サンケンオプト プロダクツ 株式会社	(石川県志賀町)	半導体 デバイス CCFL PS	製造設備	1,056	6		3	16	1,083	140

(3) 在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
アレグロ マ イクロシステ ムズ エルエ ルシー	(米国マサ チューセツ 州ウースター他)	半導体 デバイス	製造設備	1,952	8,623	1,022 (437)		479	10,774	3,604
韓国サンケン 株式会社	(韓国馬山市)	CCFL	製造設備	61	0	〔5〕		9	71	114
ピーティー サンケン インドネシア	(インドネシア 西ジャワ州 ブカシ)	PM	製造設備	137	2	〔50〕	89	0	229	1,875
大連三壘電気 有限公司	(中国遼寧省 大連市)	半導体 デバイス PM	製造設備	636	131	〔17〕		17	785	286
三壘力達電気 (江陰) 有限公司	(中国江蘇省 江陰市)	PS	製造設備	71	51	〔12〕		45	168	129
ポーラー セミ コンダクター エルエルシー	(米国 ミネソタ州 ブルーミント ン)	半導体 デバイス	製造設備	1,627	3,681	498 (55)		3,928	9,736	516

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額に消費税等は含まれておりません。

2 土地の一部を賃借しております。〔 〕は外書であります。

3 上記の他、主要なリース設備として以下のものがあります。

在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	年間リース料	リース契約残高
アレグロ マイクロ システムズ エルエル シー	(米国マサチュー セツ州ウース ター他)	半導体 デバイス	製造設備	234百万円	1,214百万円

(訂正後)

(2) 国内子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
石川サンケン 株式会社	堀松工場 他3工場 (石川県 志賀町)	半導体 デバイス	製造設備	3,391	1,982	1,299 (463) 〔10〕	1,927	506	9,106	1,253
山形サンケン 株式会社	(山形県 東根市)	半導体 デバイス	製造設備	2,652	1,786	638 (65)	1,341	108	6,527	481
鹿島サンケン 株式会社	(茨城県 神栖市)	半導体 デバイス	製造設備	468	328	127 (8) 〔10〕	17	100	1,041	332
福島サンケン 株式会社	(福島県 二本松市)	半導体 デバイス	製造設備	1,333	764	300 (50)	495	65	2,958	334
サンケンオプト プロダクツ 株式会社	(石川県 志賀町)	半導体 デバイス CCFL PS	製造設備	1,056	6		3	16	1,083	140

(3) 在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
アレグロ マ イクロシステ ムズ エルエ ルシー	(米国マサ チューセツ 州ウースター他)	半導体 デバイス	製造設備	1,952	8,623	1,022 (437)		1,203	12,801	3,409
韓国サンケン 株式会社	(韓国馬山市)	CCFL	製造設備	61	0	〔5〕		9	71	114
ピーティー サンケン インドネシア	(インドネシア 西ジャワ州 ブカシ)	PM	製造設備	137	2	〔50〕	89	0	229	1,875
大連三壱電気 有限公司	(中国遼寧省 大連市)	半導体 デバイス PM	製造設備	636	131	〔17〕		17	785	286
三壱力達電気 (江陰) 有限公司	(中国江蘇省 江陰市)	PS	製造設備	71	51	〔12〕		45	168	129
ポーラー セミ コンダクター エルエルシー	(米国 ミネソタ州 ブルーミント ン)	半導体 デバイス	製造設備	1,627	3,681	498 (55)		3,928	9,736	516

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額に消費税等は含まれておりません。

2 土地の一部を賃借しております。〔 〕は外書であります。

3 上記の他、主要なリース設備として以下のものがあります。

在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	年間リース料	リース契約残高
アレグロ マイクロ システムズ エルエル シー	(米国マサチュー セツ州ウース ター他)	半導体 デバイス	製造設備	234百万円	1,214百万円

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

(訂正前)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	18,721	14,805	0.92	
1年以内に返済予定の長期借入金	5,025			
1年以内に返済予定のリース債務	1,044	1,238	1.85	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,506	12,500	0.99	平成26年4月～平成27年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,201	3,157	1.81	平成26年4月～平成30年8月
其他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内)	14,500	13,000	0.29	
合計	49,998	44,700		

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
長期借入金	2,500	10,000			
リース債務	1,151	1,094	801	109	0

(訂正後)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	18,721	14,805	0.92	
1年以内に返済予定の長期借入金	5,025			
1年以内に返済予定のリース債務	1,044	1,238	1.85	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,506	12,500	0.99	平成26年4月～平成27年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,201	3,157	1.81	平成26年4月～平成30年8月
其他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内)	14,500	13,000	0.29	
合計	49,998	44,700		

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
長期借入金	7,500	5,000			
リース債務	1,151	1,094	801	109	0

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【注記事項】

(リース取引関係)

3 転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額

(2) リース債務

(訂正前)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
流動負債	963百万円	<u>1,206百万円</u>
固定負債	3,049百万円	<u>3,091百万円</u>

(訂正後)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
流動負債	963百万円	<u>1,072百万円</u>
固定負債	3,049百万円	<u>2,806百万円</u>